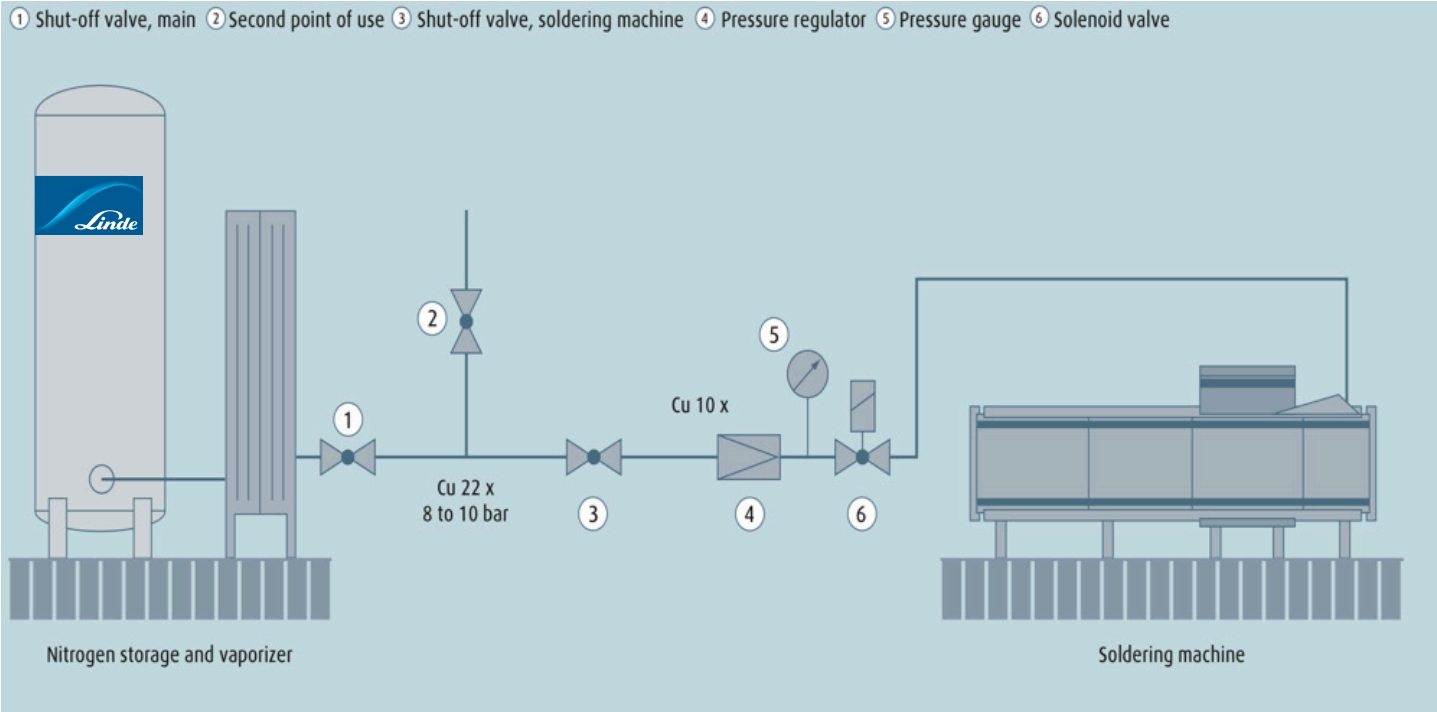
Haciendo nuestro mundo más productivo

SOLDERFLEX®

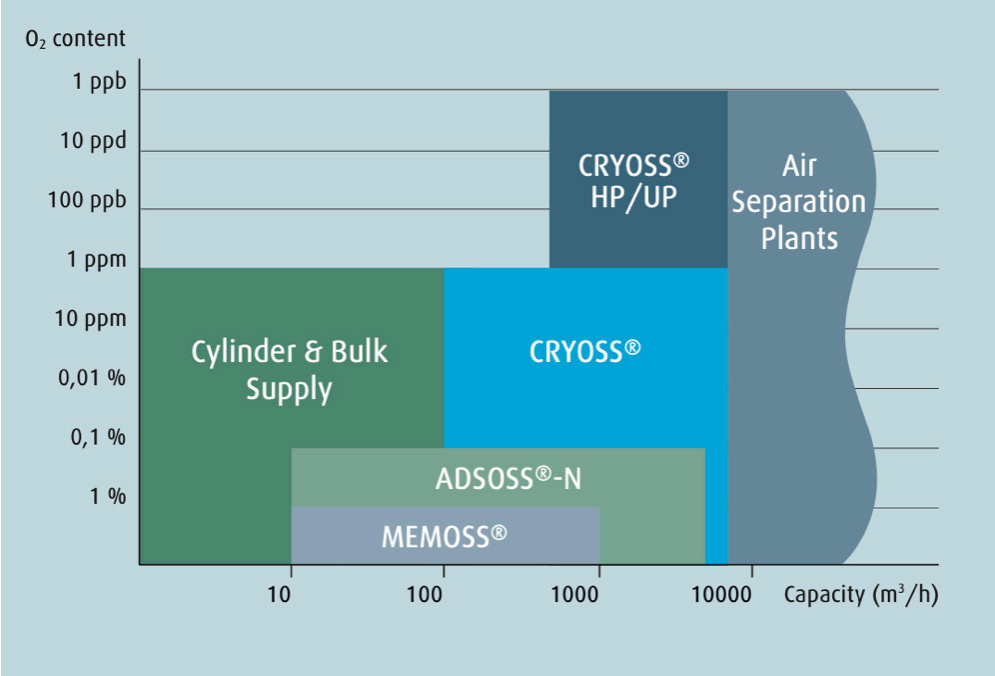
Soluciones para tratamiento térmico

SOLDERFLEX®

Especial para sistemas de soldadura de ola y reflujo con nitrógeno



Sistema de suministro de atmósfera inerte estándar de gas nitrógeno para máquinas de soldering con sistema SOLDERFLEX® SGS.

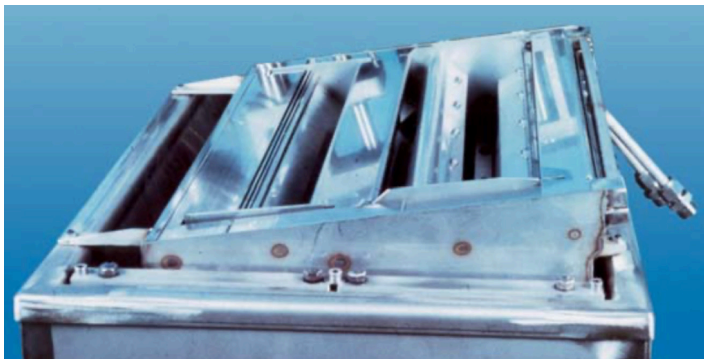


Métodos de producción de nitrógeno en función de la pureza y la cantidad suministrada.

Sistema de inertización local - LIS

SOLDERFLEX® LIS es un sistema de inertización local para máquinas de soldadura de ola que convierten la soldadura en aire en soldadura en condiciones de gas inerte. El sistema LIS permite la soldadura con nitrógeno después de algunos trabajos de reconstrucción de la linea de Soldering.

Sustancialmente se reduce la escoria y, en consecuencia, tenemos un menor consumo de soldadura, un menor mantenimiento y volumen de trabajos de reparación. Estas son las mejores ventajas de este método. En todos los casos, la calidad de las placas de circuito impreso PCB es mejorado. LIS es muy útil para trabajar con soldaduras sin plomo.



Una máquina de soldering después de reconstrucción a SOLDERFLEX® LIS.

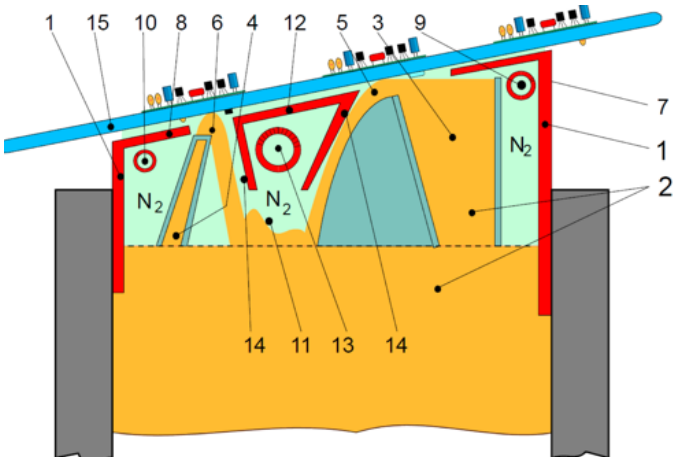
El sistema de inertización local (LIS) incluye

Campana de acero inoxidable sobre el baño de soldadura con aperturas para las olas. Tres difusores de gas. Un panel de control del gas.

Esta sencilla instalación tiene tanto éxito porque el gas inerte se inyecta directamente en el punto donde se genera la mayor parte de la escoria. El gas inerte (nitrógeno) evita la formación de escoria en el área de transición entre la tarjeta impresa PCB, el área de contacto entre el baño y la (s) ola (s) de metal líquido.

Una atmósfera que garantiza menos de 40 ppm de oxígeno residual por debajo del PCB.

El sistema LIS se puede instalar en prácticamente cualquier máquina de soldadura atmosférica.

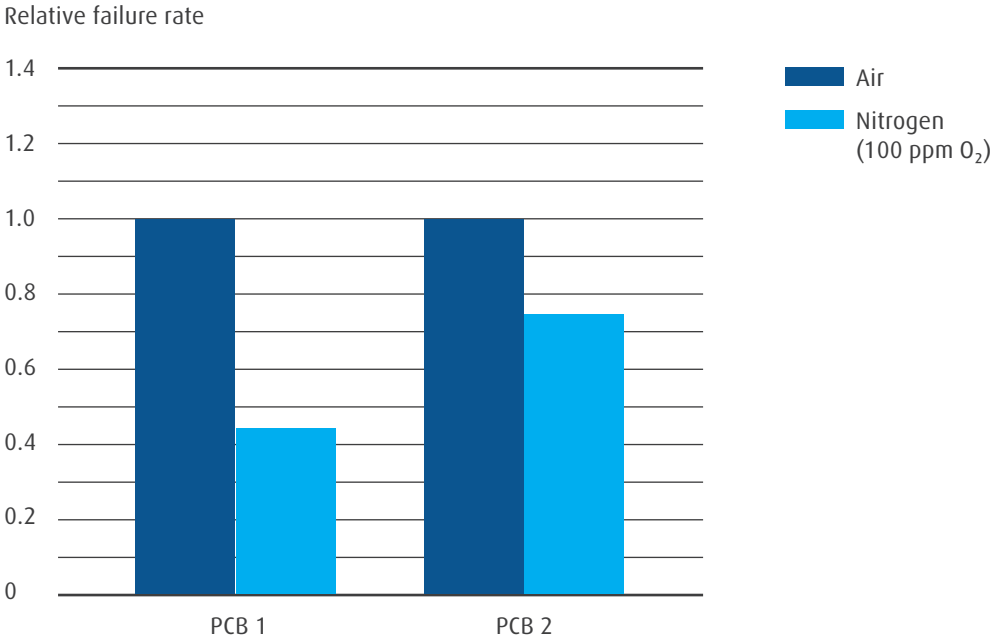


1,7,8,12 construcción de acero inoxidable
2,3,4 baño de estaño,
5 y 6 olas de soldadura bombeada
5 ola principal y
6 ola pre-soldadura de los chips
9,10,3 alimentación de gas;
11 zonas de formación de escoria
14 guía de las placas

Muchos clientes han confirmado las siguientes ventajas del sistema de inertización local después de años de uso práctico:

- Reducción de escoria de 50% a 80%.
- Reducción del consumo de soldadura en más del 60%.
- Solo los ahorros en soldadura ya compensan los costos del consumo de gas inerte.
- Mejora de la calidad y reducción del número de retrabajos.
- Menos mantenimiento, hasta un 30%.
- Reducción del uso de fundente y aplicación de fundentes de menor contenido de sólidos.
- Impresiones PCB más limpias después de soldar. Procedimiento de instalación sencillo y fácil acceso a la máquina.
- Bajo consumo de nitrógeno, 4-8 m^3 / h.
- Se puede adaptar a la mayoría de las marcas de máquinas.

Uso con las aleaciones sin plomo



Ejemplo de la posible mejora en la calidad de la soldadura mediante el uso del sistema SOLDERFLEX® LIS.

Sistema de doble inertizado - DIS

SOLDERFLEX® Double Inerting System (DIS) es una solución confiable para la utilización óptima del gas inerte en sistemas de soldadura por ola de nitrógeno de túnel completo. Los beneficios de utilizar nitrógeno para los procesos de soldadura están bien conocidos y aceptados sin objeciones. Desde el sistema de inertización local SOLDERFLEX® de Linde (LIS) cual está disponible, es posible toda vía modernizar las máquinas de soldadura por ola para el uso de nitrógeno sin cualquier esfuerzo notable. SOLDERFLEX® DIS es nuestro desarrollo más reciente que ofrece ventajas adicionales cuando se utiliza en sistemas de soldadura por ola de nitrógeno de túnel completo, con un área inertizada de proceso más amplia, resultados de soldadura más uniformes y una reducción significativa en los costos operativos.

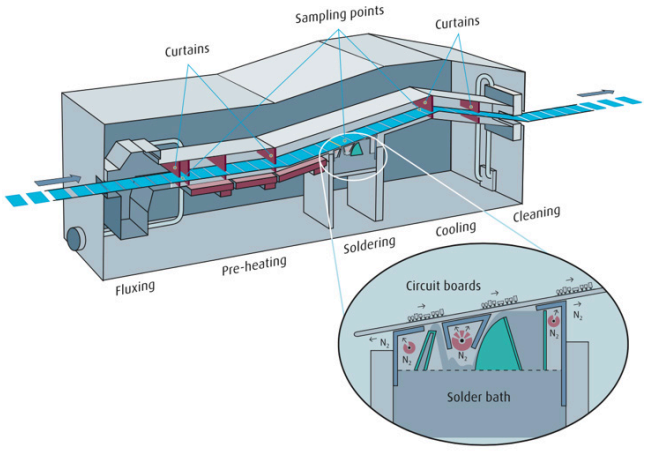
La idea fundamental de SOLDERFLEX® DIS es integrar un sistema de inertización local especialmente diseñado (nitrógeno campana) en una máquina de soldadura por ola de túnel completo y alimentar el gas inerte completo a través de esta campana. En consecuencia, el nitrógeno se introduce en el proceso en la posición en la que ofrece el efecto más significativo sobre la gestión del proceso y la calidad de la soldadura

Reducción del consumo de nitrógeno más del 40% con mejores resultados de soldadura.

Condiciones de proceso muy estables sin influencias del entorno ambiental:

- Ciclos de producción de tres a seis veces más largos sin necesidad de interrupciones de limpieza o mantenimiento.
- Menor consumo de flujo de nitrógeno.
- Reducción de los costos generales de producción.

Instalación SOLDERFLEX® DIS en la zona de soldadura de ola.

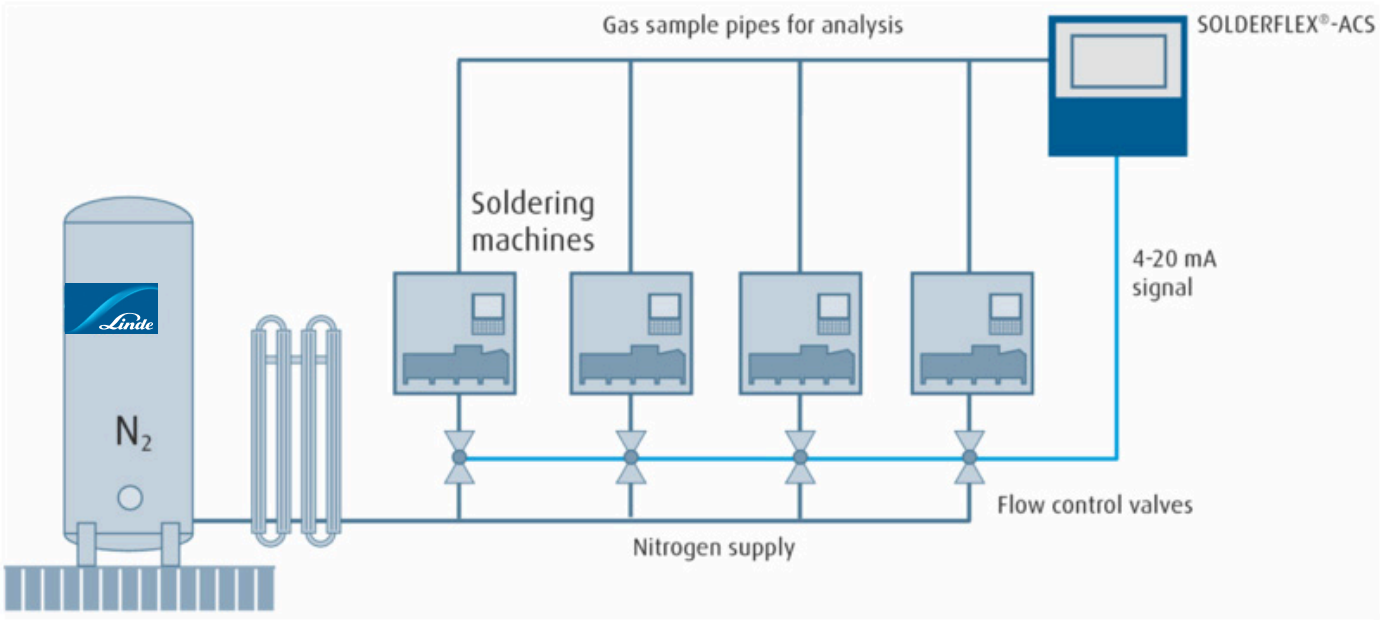


Vista general del sistema SOLDERFLEX® DIS en la linea de proceso de zona soldadura de ola .

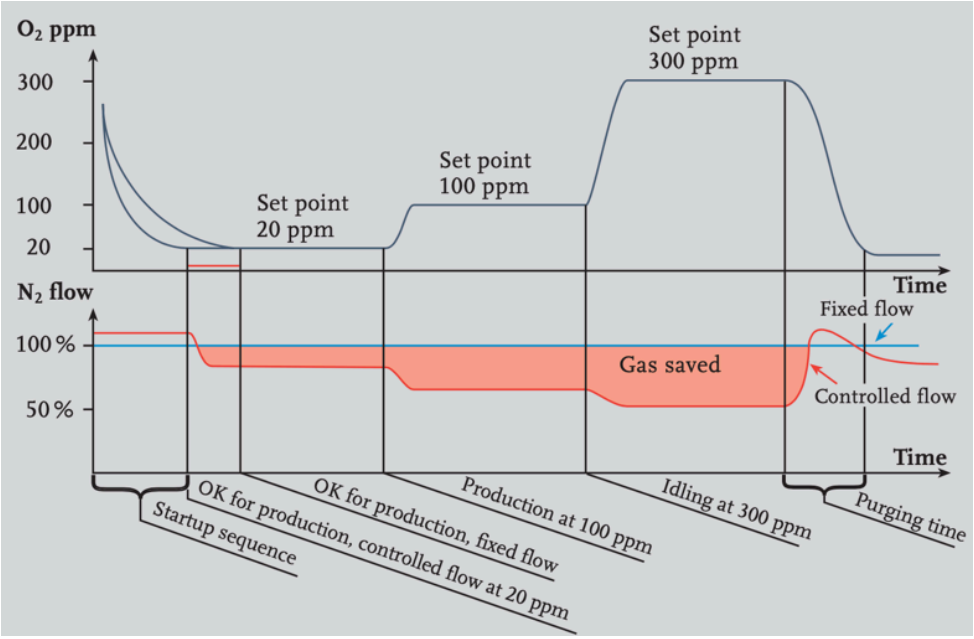
SOLDERFLEX® ACS

Atmosphere Control System para soldadura, almacenamiento y aplicaciones de inertización

SOLDERFLEX® ACS es un sistema compacto de control automático de flujo y control del nivel de oxígeno para procesos de inertizado como soldadura tipo soldering por reflujo y ola, almacenamiento, recocido y brazing. Eso se puede integrar usando una computadora de proceso del cliente o usarse como una unidad independiente. El sistema proporciona un control total sobre el contenido de oxígeno en el horno al mismo tiempo que ajusta el consumo de nitrógeno al mínimo, pero suficiente para el logro de la calidad necesaria. El sistema también puede manejar diferentes recetas de proceso como para su grabación, almacenamiento y también poder ver estos datos históricos.



Vista general del sistema SOLDERFLEX® ACS en el sitio del cliente como control de los parámetros del proceso y suministro de atmosfera de N_2.



Ahorros de la atmosfera de gas nitrógeno logrado mediante el uso del sistema de control de atmósfera SOLDERFLEX® ACS.

Características y Beneficios

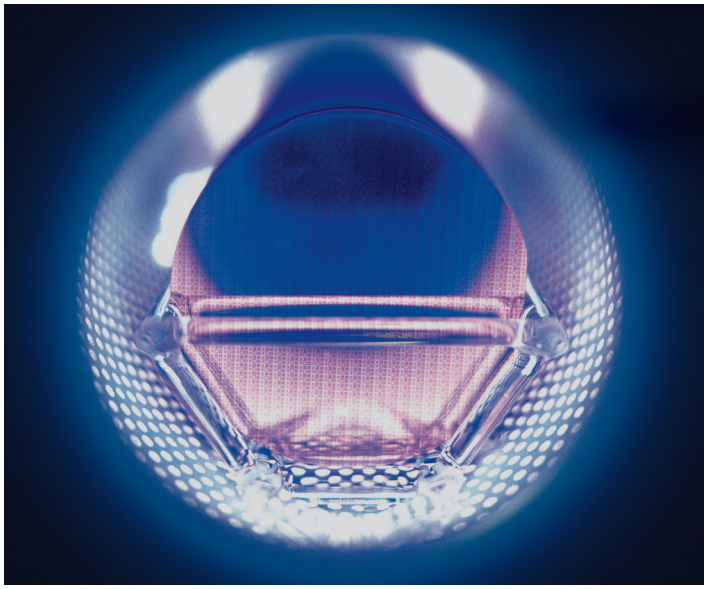
- Ahorro de gas de hasta un 40%.
- Solución rentable con hasta 4 puntos de análisis.
- Alarmas por desviaciones de la configuración.
- Fácil de operar e implementar.
- Apoyo en el trabajo de garantía de calidad gracias a las capacidades de registro integradas.
- Computadora de proceso programable en entorno Windows NT.
- Tecnología de sensores de oxígeno de última generación insensible a los residuos de flujo.
- Sistema de control de flujo (1 a 4 válvulas).
- Arranque / paro remoto (producción, modo idle, tiempos muertos entre lotes) SOLDERFLEX® es una marca registrada de Linde.

SOLDERFLEX® PT (Plasma Treatment)

Tratamiento con plasma es un tratamiento de materiales y componentes electrónicos en medio de plasma de baja temperatura

El plasma de baja temperatura es un plasma técnico que se caracteriza como un gas eléctricamente conductor con reactividad química extrema y calor tangible bajo.
El tratamiento con plasma a baja temperatura es cada vez más y más importante como proceso principal o auxiliar en la industria electrónica.

El tratamiento es posible como a bajas presiones tanto y en condiciones ambientales normales y es usado principalmente para limpieza de las obleas de silicio usadas para construcción de microcircuitos, semiconductores, circuitos integrados, células solares, rectificadores electrónicos, etc....productos para la industria de microelectrónica (Wafers) en condiciones de plasma a baja presión.



Proceso de limpieza de obleas (Wafers) de silicio en plasma a baja presión usadas para la construcción de microcircuitos integrados, semiconductores, celdas solares, etc.

Linde México